

UEFI 設定公用程式

1 簡介

本章節說明使用 UEFI 設定公用程式設定您系統的方式。您可在開啟電腦電源後立即按下 <F2> 或 執行 UEFI 設定公用程式，否則開機自我測試 (POST) 將繼續原本的測試常式。若您想要在 POST 後進入 UEFI 設定公用程式，請按下 <Ctl> + <Alt> + <Delete>，或按下系統機殼上的重設按鈕重新啟動系統。您也可先關系統電源，再重新開啟而重新啟動。

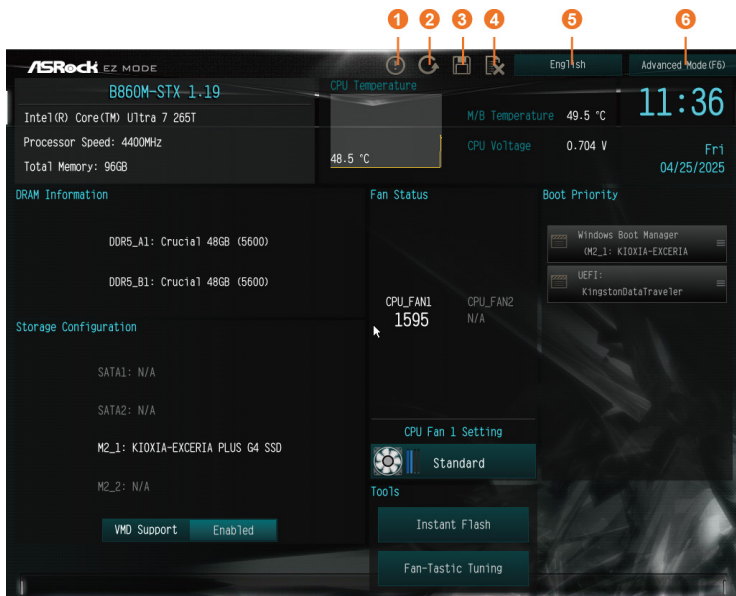


因為 UEFI 軟體會持續更新，所以下列 UEFI 設定畫面及說明僅供參考，可能會與您在畫面上看到的不完全相同。

2 EZ 模式

根據預設，EZ 模式畫面會在進入 BIOS 設定程式時出現。EZ 模式是包含許多系統目前狀態讀數的儀表板。您可查看最重要的系統資訊，例如 CPU 速度、DRAM 頻率、SATA 資訊、風扇轉速等。

按下 <F6> 或按一下畫面右上方的「Advanced Mode (進階模式)」按鈕，可切換至包含更多選項的「進階模式」。



編號	功能
1	Help (說明)
2	Load UEFI Defaults (載入 UEFI 預設值)
3	Save Changes and Exit (儲存變更並結束)
4	Discard Changes (捨棄變更)
5	Change Language (變更語言)
6	Switch to Advanced Mode (切換至進階模式)

3 進階模式

進階模式提供更多 BIOS 設定選項。請參閱以下章節以瞭解詳細設定。

若要存取 EZ 模式，請按下 <F6> 或按一下畫面右上方的「EZ Mode (EZ 模式) 」按鈕。

3.1 UEFI 功能表列

在畫面最上方的功能表列共有下列選項：

主要	適用於設定系統時間 / 日期資訊
OC Tweaker	適用於超頻設定
進階	適用於進階系統設定
工具	實用工具
硬體監視器	顯示目前的硬體狀態
安全性	適用於安全性設定
開機	適用於設定開機設定及開機優先順序
結束	結束目前畫面或 UEFI 設定公用程式

3.2 導覽鍵

使用 <←> 鍵或 <→> 鍵選擇功能表列上的選項，再使用 <↑> 鍵或 <↓> 鍵上下移動游標選擇項目，然後按下 <Enter> 進入子畫面。您也可以使用滑鼠點選您所需的項目。

請核對下表，確認各導覽鍵的說明。

導覽鍵	說明
+ / -	變更選取項目的選項
<Tab>	切換至下一個功能
<PGUP>	前往上一頁
<PGDN>	前往下一頁
<HOME>	前往畫面最上方
<END>	前往畫面最下方
<F1>	顯示一般說明畫面
<F7>	捨棄變更並結束設定公用程式
<F9>	在所有設定中，載入最佳預設設定值
<F10>	儲存變更並結束設定公用程式
<F12>	列印畫面
<ESC>	跳至結束畫面或結束目前的畫面

4 主畫面

當您進入 UEFI 設定公用程式時，主畫面將出現並顯示系統一覽。



BIOS 設定是否可用及其路徑根據不同的型號與 BIOS 版本而定。

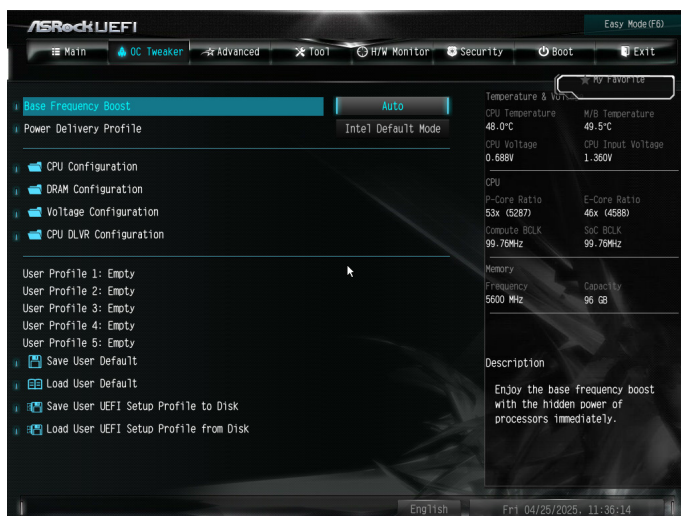


我的最愛

顯示您的 BIOS 項目集合。按下 F5 即可新增 / 移除您的最愛項目。

5 OC Tweaker 畫面

在 OC Tweaker 畫面中，您可設定超頻功能。



CPU Indicator (CPU 指示器)

CPU 指示器根據效能和能力指定點數以評估 CPU，協助使用者將超頻設定最佳化以提升效能。

CPU Configuration (CPU 設定)

CPU Turbo Ratio Information (CPU Turbo 倍頻資訊)

按 [Enter] 檢視 CPU Turbo 倍頻資訊。

CPU P-Core Ratio (CPU P-Core 倍頻)

CPU 速度取決於 CPU P-Core 倍頻乘以 BCLK。提高 CPU P-Core 倍頻將提高內部 CPU 時脈速度，不影響其他元件的時脈速度。

設定選項：[Auto (自動)] [所有核心] [每個核心] [每個核心指定]

AVX2 Ratio Offset (AVX2 比率偏移)

AVX2 比率偏移針對 AVX 工作負載指定 CPU 比率的負向偏移。AVX 是較重的工作負載，可降低 AVX 比率，以確保 SSE 工作負載的最大比率。

CPU E-Core Ratio (CPU E-Core 倍頻)

E-Core 速度是由 E-Core 倍頻乘以 BCLK 決定。增加 E-Core 倍頻將增加內部 E-Core 時脈速度，不影響其他元件的時脈速度。

設定選項：[Auto (自動)] [所有核心] [每個核心] [每個核心指定]

CPU Cache Ratio (CPU 快取率)

CPU 內部匯流排速率。最大值應與 CPU 倍頻相同。

Min Cache Ratio (最小快取率)

CPU 內部匯流排最小速率。若要針對非 K CPU 使快取率與 P-Core 倍頻一致，您可以嘗試將最小快取率限制與 CPU 快取率同步。

MemSS Max OC Ratio (MemSS 最大 OC 比)

讓您設定記憶體子系統的最大 OC 比。範圍非渦輪最大值 - 109。

NGU Max OC Ratio (NGU 最大 OC 比)

讓您設定 NGU 的最大 OC 比。範圍非渦輪最大值 - 34。

GT Frequency (GT 頻率)

讓您設定整合式 GPU 的頻率，以 MHz 為單位。使用內建顯示卡時，會出現此項目。

CPU D2D Ratio (CPU D2D 比率)

讓您在 15 到 40 的範圍內，設定 CPU D2D 比率。

BCLK Aware Adaptive Voltage (BCLK 感知適應性電壓)

讓您將 BCLK 感知適應性電壓，設為啟用或停用。啟用後，pcode 將在計算 CPU V/F 曲線時，感知 BCLK 頻率。這適合 BCLK OC 以避免高電壓覆寫。

設定選項：[Enabled (啟用)] [Disabled (停用)]

Boot Max Frequency (啟動最大頻率)

讓您啟用或停用 CPU 帶的啟動最大頻率。

Boot Performance Mode（提升效能模式）

預設值為最大非渦輪效能模式。將保持 CPU Flex 比率，直到 OS 遞交。最大電池模式會將 CPU 倍頻設為 x8，直到 OS 遞交。建議將此選項用於 BCLK 超頻。

設定選項：[最大電池] [最大非渦輪效能] [渦輪效能]

CPU BGREF Mode（CPU BGREF 模式）

讓您在正常與帶隙旁路之間，選擇 CPU 帶隙參考模式。CPU 帶隙參考模式 - 預設電壓為正常。

設定選項：[正常] [帶隙旁路]

VCCIA Boot Voltage（VCCIA 啟動電壓）

讓您在標稱值與高電壓之間，選擇 VCCIA 啟動電壓。VCCIA 啟動電壓 - 預設電壓為標稱值，為了支援高電壓，BIOS 可將 VCCIA 啟動電壓設為高於 1.65v（最大 2.01v）。

VCCSA Boot Voltage（VCCSA 啟動電壓）

讓您在標稱值與高電壓（最高 1.2/1.3V）之間，選擇 VCCSA 啟動電壓。VCCSA 啟動電壓 - 預設電壓為標稱值，為了支援高電壓，BIOS 可設定 EPOC2 位元，將電壓提升至最高 1.2/1.3V。0 - 標稱值。1 - 高電壓（最高 1.2/1.3V）

設定選項：[標稱值] [高電壓]

Ring to Core Ratio Offset（環形與核心比率偏移）

停用環形與核心比率偏移，使環形與核心能以相同頻率運作。

設定選項：[Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

FLL Overclock Mode（FLL 超頻模式）

讓您從範圍 1 到 3 中，選擇 FLL 模式值。

0x0 = 無超頻。

0x1 = 以標稱 (0.5-1x) 參考時脈頻率進行比率超頻。

0x2 = 以極高 (3-5x) 參考時脈頻率進行 BCLK 超頻，比率限制在 63。

SA PLL Frequency（SA PLL 頻率）

讓您設定 SA PLL 頻率。

設定選項：[Auto（自動）] [3200 MHz] [1600 MHz]

BCLK TSC HW Fixup（BCLK TSC HW 修復）

從 PMA 到 APIC 的 TSC 複製期間，停用 BCLK TSC HW 修復。

設定選項：[Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

Intel SpeedStep Technology

Intel SpeedStep 技術允許處理器在多項頻率及電壓點之間切換，以獲得最佳省電及散熱效率。Intel SpeedStep 技術設為停用、且 Intel 渦輪加速技術設為啟用時，可固定 CPU Turbo 倍頻。

設定選項：[Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

Intel Turbo Boost Technology（Intel 渦輪加速模式 (Turbo Boost) 技術）

操作系統要求最高效能狀態時，Intel 渦輪加速模式 (Turbo Boost) 技術可讓處理器以基本頻率以上執行。

設定選項：[Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

Intel Speed Shift Technology（Intel Speed Shift 技術）

讓您啟用或停用 Intel Speed Shift 技術支援。啟用將開放 CPPC v2 介面，以允許硬體控制 P 狀態。若要獲得對 Intel Turbo Boost Max 技術 3.0 (ITBMT 3.0) 的最佳支援，必須啟用 Intel Speed Shift 技術。如果 CPU 不支援 ITBMT 3.0，選項將仍然呈灰色。

設定選項：[Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

Intel Turbo Boost Max Technology 3.0（Intel Turbo Boost Max 技術 3.0）

讓您啟用或停用 Intel Turbo Boost Max 技術 3.0 (ITBMT 3.0) 支援。停用將報告 _CPC 物件中，最慢核心的最大比率。支援 ITBMT 3.0 功能的處理器，至少包含一個最大比率高於其他核心的處理器核心。

設定選項：[Auto（自動）] [Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

Intel Dynamic Tuning Technology

讓您啟用或停用 Intel Dynamic Platform Thermal Framework。

Intel Thermal Velocity Boost Voltage Optimizations（Intel Thermal Velocity Boost 電壓最佳化）

此服務可針對具備 Intel Thermal Velocity Boost (TVB) 功能的處理器控制，以熱為基礎的電壓最佳化。

設定選項：[Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

Enhanced Thermal Velocity Boost（改良型 Thermal Velocity Boost）

啟用此項目時，當溫度達到支援產品的預設閾值，將限制使用者。建議停用以進行超頻。是否出現此項目視您在主機板上使用的 CPU 而定。

設定選項：[Auto（自動）] [Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

CPU Tj Max（CPU Tj 最大值）

讓您設定 CPU T_j 最大值，以調整 TCC 目標溫度。在攝氏 62 至 115 度的範圍內，支援 T_j 最大值。

Long Duration Power Limit（長時間功耗限制）

讓您設定封裝功率限制 1，以瓦為單位。超出限制時，CPU 倍頻在經過一段時間後將變低。下限可保護 CPU 並節省功率，而上限則可改善效能。

Long Duration Maintained（長時間持續時間）

讓您設定超過長時間功率限制時，降低 CPU 倍頻之前的時間長度。

Short Duration Power Limit（短時間功耗限制）

讓您設定封裝功率限制 2，以瓦為單位。超出限制時，CPU 倍頻將立即變低。下限可保護 CPU 並節省功率，而上限則可改善效能。

CPU Core Current Limit（CPU 核心電流限制）

電壓調節器電流限制。此值表示在任何時間允許的最大瞬時電流。

GT Current Limit（GT 電流限制）

電壓調節器電流限制。此值表示在任何時間允許的最大瞬時電流。使用內建顯示卡時，會出現此項目。

IA CEP Enable（IA CEP 啟用）

讓您啟用或停用 CEP (Current Excursion Protection) 支援。

GT CEP Enable（GT CEP 啟用）

讓您啟用或停用 CEP (Current Excursion Protection) 支援。

Process Vmax Limit（程序 Vmax 限制）

此選項可讓使用者停用 P-core 功率密度節流，以進行超頻。停用後，BIOS 無法在同一個重設週期中加以啟用。必須進行暖重設或冷重設，才能再次啟用保護。

P-core Power Density Throttle（P-core 功率密度節流）

節流以進行超頻。停用後，BIOS 無法在同一個重設週期中加以啟用。必須進行暖重設或冷重設，才能再次啟用保護。

DRAM Configuration（DRAM 設定）

Memory Information（記憶體資訊）

讓您瀏覽記憶體模組的序列存在偵測 (SPD) 與 Intel Extreme Memory Profile (XMP)。

DRAM Timing Configuration（DRAM 時脈設定）

Memory Ratio（記憶體比率）

頻率將等於 PLL 比率 * 齒輪比（2 或 4）* 參考時脈 (33.33)。

DRAM Frequency（DRAM 頻率）

若選擇 [Auto]（自動），主機板將偵測記憶體模組是否插入，並自動指派適合的頻率。

DRAM Gear Mode（DRAM Gear 模式）

讓您選擇 DRAM Gear 模式。高檔位適合高頻率。

設定選項：[Auto（自動）] [2] [4]

SAGV

讓您啟用或停用系統代理程式 Geyserville。啟用時，會出現以下選項以供設定：

SA GV Mask（SA GV 遮罩）

系統代理程式 Geyserville 此項目可讓您設定用於頻率切換點的 BIT。

設定選項：

[啟用點：第一和第二]

[啟用點：第一、第二、第三]

[啟用所有點：第一、第二、第三、第四]

1st Point Frequency（第一點頻率）

讓您指定該點的頻率。

1st Point Gear（第一點齒輪）

該 SAGV 點的齒輪比。

設定選項：[Auto（自動）] [2] [4]

2nd Point Frequency（第二點頻率）

讓您指定該點的頻率。

2nd Point Gear（第二點齒輪）

該 SAGV 點的齒輪比。

設定選項：[Auto（自動）] [2] [4]

3rd Point Frequency（第三點頻率）

讓您指定該點的頻率。

3rd Point Gear（第三點齒輪）

該 SAGV 點的齒輪比。

設定選項：[Auto（自動）] [2] [4]

4th Point Frequency（第四點頻率）

讓您指定該點的頻率。

4th Point Gear（第四點齒輪）

該 SAGV 點的齒輪比。

設定選項：[Auto（自動）] [2] [4]

Primary Timing（主要時序）

CAS# Latency (tCL)（CAS# 延遲 (tCL)）

傳送行位址至記憶體與資料開始回應之間的時間。

RAS# to CAS# Delay (tRCD)（RAS# 至 CAS# 延遲 (tRCD)）

RAS# 至 CAS# 延遲：在開啟記憶體列及存取記憶體行之間所需的時脈週期數。

Row Precharge (tRP)（列預充電 (tRP)）

在發佈預充電命令及下一列開啟之間所需的時脈週期。

RAS# Active Time (tRAS)（RAS# 啓用時間 (tRAS)）

在 bank active 命令與發佈預充電命令之間所需的時脈週期。

RAS# Cycle Time (tRC)（RAS# 週期時間 (tRC)）

可設定最小 active 至 active / 重新整理時間。

Command Rate (CR)（命令速率 (CR)）

在選取記憶體晶片時以及可發佈首次啟動命令時之間的延遲。

Secondary Timing（次要時序）

Write Recovery Time (tWR)（寫入恢復時間 (tWR)）

在可預充電 active bank 之前，完成有效寫入作業後必須經過的延遲時間。

Refresh Cycle Time 2 (tRFC2)（重新整理週期時間 2 (tRFC2)）

從 Refresh（重新整理）命令直到發佈第一個 Activate（啟動）命令至相同次序的時脈數。

Refresh Cycle Time per Bank (tRFCpb)（每記憶庫重新整理週期時間 (tRFCpb)）

從重新整理命令（每記憶庫），直到發出第一個啟動命令至同一記憶庫的時脈數。

Refresh Delay Same Bank (tREFSBRD)（重新整理延遲相同記憶庫 (tREFSBRD)）

讓您將 tREFSBRD、相同記憶庫重新整理設為 ACT 延遲。

Refresh Interval x9 (tREFIx9) (重新整理間隔 x9 (tREFIx9))

讓您針對每記憶庫重新整理之間的最長時間設定 tREFIx9。

Refresh Interval (tREFI) (重新整理間隔 (tREFI))

讓您以平均週期間隔，設定重新整理週期。

CAS 至 CAS CMD 延遲 (tCCD_L)

讓您設定內部寫入至讀取命令延遲時間。

寫入 CAS 至 CAS CMD 延遲 (tCCD_L_WR)

讓您設定內部寫入至寫入命令延遲時間。

Write to Read Delay (tWTR_L) (寫入到讀取延遲 (tWTR_L))

在相同內部組別中的上次有效寫入作業及下次讀取命令之間的時脈數。

Write to Read Delay (tWTR_S) (寫入到讀取延遲 (tWTR_S))

在相同內部組別中的上次有效寫入作業及下次讀取命令之間的時脈數。

RAS to RAS Delay (tRRD_L) (RAS 至 RAS 延遲 (tRRD_L))

在相同次序不同組別中啟動的兩列間時脈數。

RAS to RAS Delay (tRRD_S) (RAS 至 RAS 延遲 (tRRD_S))

在相同次序不同組別中啟動的兩列間時脈數。

Read to Precharge (tRTP) (讀取到預充電 (tRTP))

在相同次序中，於讀取命令至列預充電命令之間插入的時脈數。

Four Activate Window (tFAW) (四啟動視窗 (tFAW))

在相同次序中允許的四個啟動時間視窗。

CAS Write Latency (tCWL) (CAS 寫入延遲 (tCWL))

設定 CAS 寫入延遲。

Power Down Timing (省電時序)**tCKE**

設定 DDR5 一進入自我重新整理模式後，在內部啟動最少單一重新整理命令的時間長度。

tXP

讓您設定 tXP。

tCPDED

讓您設定 tCPDED。

tRDPDEN

讓您設定 tRDPDEN。

tWDPDEN

讓您設定 tWDPDEN。

tCKCKEH

讓您設定 tCKCKEH。

tCSH

讓您設定 tCSH。

tCSH

讓您設定 tCSH。

tCSL

讓您設定 tCSL。

tCA2CS

讓您設定 tCA2CS。

tPRPDEN

讓您設定 tPRPDEN。

tOSCO

讓您設定 tOSCO。

tMRR

讓您設定 tMRR。

MISC Timing (MISC 時序)

tRPab

讓您設定 tRPab。

tRDPRE

讓您設定 tRDPRE。

tPPD

讓您設定 tPPD。

tWRPRE

讓您設定 tWRPRE。

DeratingExt

讓您設定 DeratingExt。

DecTcwl

讓您設定 DecTcwl。

AddTcwl

讓您設定 AddTcwl。

tCCDByteCasDelta

讓您設定 tCCDByteCasDelta。

tPrefRi

讓您設定 tOrefRi。

RefreshHpWm

讓您設定 RefreshHpWm。

RefreshPanicWm

讓您設定 RefreshPanicWm。

RefreshPanicWm

讓您設定 RefreshAbrRelease。

tRFM

讓您設定 tRFM。

tXSR

讓您設定 tXSR。

tSR

讓您設定 tSR。

tXSDLL

讓您設定 tXSDLL。

tZQCS

讓您設定 tZQCS。

tZQCAL

讓您設定 tZQCAL。

tZQCSPeriod

讓您設定 tZQCSPeriod。

tMRD

讓您設定 tMRD。

Turn Around Timing（轉迴時序）

TAT Training Value（TAT 訓練值）

tRDRD_sg

在模組讀取至讀取延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [127]

tRDRD_dg

在模組讀取至讀取延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [127]

tRDRD_dr

在模組讀取至讀取延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [255]

tRDRD_dd

在模組讀取至讀取延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [255]

tRDWR_sg

在模組讀取至寫入延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [255]

tRDWR_dg

在模組讀取至寫入延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [255]

tRDWR_dr

在模組讀取至寫入延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [255]

tRDWR_dd

在模組讀取至寫入延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [255]

tWRRD_sg

在模組寫入至讀取延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [511]

tWRRD_dg

在模組寫入至讀取延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [511]

tWRRD_dr

在模組寫入至讀取延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [127]

tWRRD_dd

在模組寫入至讀取延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [127]

tWRWR_sg

在模組寫入至寫入延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [127]

tWRWR_dg

在模組寫入至寫入延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [127]

tWRWR_dr

在模組寫入至寫入延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [127]

tWRWR_dd

在模組寫入至寫入延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [255]

TAT Runtime Value（TAT 執行階段值）

tRDRD_sg

在模組寫入至讀取延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [127]

tRDRD_dg

在模組寫入至讀取延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [127]

tRDRD_dr

在模組寫入至讀取延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [255]

tRDRD_dd

在模組寫入至讀取延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [255]

tRDWR_sg

在模組寫入至讀取延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [255]

tRDWR_dg

在模組寫入至讀取延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [255]

tRDWR_dr

在模組寫入至讀取延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [255]

tRDWR_dd

在模組寫入至讀取延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [255]

tWRRD_sg

在模組寫入至讀取延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [511]

tWRRD_dg

在模組寫入至讀取延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [511]

tWRRD_dr

在模組寫入至讀取延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [127]

tWRRD_dd

在模組寫入至讀取延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [127]

tWRWR_sg

在模組寫入至寫入延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [127]

tWRWR_dg

在模組寫入至寫入延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [127]

tWRWR_dr

在模組寫入至寫入延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [127]

tWRWR_dd

在模組寫入至寫入延遲之間設定。

設定選項：[Auto（自動）] [0] - [255]

Round Trip Timing（往返時序）**Round Trip Level（往返等級）**

設定往返等級。

設定選項：[最緊密] [較緊密] [緊密] [正常] [鬆散] [較鬆散] [最鬆散]

Initial RTL IO Delay Offset（初始 RTL IO 延遲偏移）

設定往返延遲 IO 延遲初始偏移。

Initial RTL FIFO Delay Offset（初始 RTL FIFO 延遲偏移）

設定往返延遲 FIFO 延遲初始偏移。

Initial RTL (MC0 A1)（初始 RTL (MC0 A1)）

設定往返延遲初始值。

Initial RTL (MC0 A1)（初始 RTL (MC0 A1)）

設定往返延遲初始值。

Initial RTL (MC1 B1)（初始 RTL (MC1 B1)）

設定往返延遲初始值。

Initial RTL MC1 B1)（初始 RTL (MC1 B1)）

設定往返延遲初始值。

RTL (MC0 A1)

設定往返延遲。

RTL(MC0 A1)

設定往返延遲。

RTL (MC1 B1)

設定往返延遲。

RTL (MC1 B1)

設定往返延遲。

ODT Setting（ODT 設定）

Force Reset Type（強制重設類型）

F10 儲存變更並退出後，強制重設類型。

設定選項：[Auto（自動）] [Cold Reset（冷重設）] [Warm Reset（暖重設）]
[Shut Down Reset（關機重設）] [Platform Specific Reset（平台特定重設）]

Retrain on Fast Fail（快速失效時重新訓練）

如果 SW MemTest 在快速流程期間失效，則以冷模式重新啟動 MRC。預設選項設為啟用。

設定選項：[Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

Retrain to Working Channel（重新訓練至工作通道）

停用失效通道後，以冷模式重新啟動 MRC。預設選項設為停用。

Exit On Failure (MRC)（失效時退出 (MRC)）

MRC 訓練步驟失效時退出。

Force ColdReset（強制 ColdReset）

強制 ColdReset 或選擇 MrcColdBoot 模式，在 MRC 執行期間需要冷啟動。注意：如果 ME 5.0MB 存在，則需要 ForceColdReset ！

Reset for MRC Failed（MRC 重設失敗）

MRC 訓練失敗後重設系統。

設定選項：[Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

MRC Training on Warm Boot（MRC 暖開機訓練）

啟用後，將在暖開機時，執行記憶體訓練。

設定選項：[Auto（自動）] [Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

MRC Fast Boot（MRC 快速開機）

啟用時，將盡可能略過部分的記憶體參考碼，以加快開機速度。

設定選項：[Auto（自動）] [Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

Voltage Configuration（電壓設定）

Voltage Mode（電壓模式）

[OC Mode（OC 模式）]：電壓範圍較大，適用於超頻。

[Stable Mode（穩定模式）]：電壓範圍較小，使系統穩定。

CPU GT Voltage（CPU GT 電壓）

讓您設定由外部電壓調節器輸入處理器的電壓。

設定選項：[Auto（自動）] [Offset Mode（偏移模式）] [Fixed Mode（固定模式）]

CPU GT Load-Line Calibration（CPU GT 負載線路校正）

CPU GT 負載線路校正有助於防止 GT 電壓在系統處於重度負載時驟降。

設定選項：[Auto（自動）] [Level 1（等級 1）] [Level 2（等級 2）] [Level 3（等級 3）] [Level 4（等級 4）] [Level 5（等級 5）]

* 是否出現 [Level 1（等級 1）] 和 [Level 2（等級 2）] 選項，視您在主機板上使用的 CPU 而定。

System Agent Voltage（系統代理程式電壓）

由外部電壓調節器輸入處理器的電壓。

設定選項：[Auto（自動）] [Offset Mode（偏移模式）] [Fixed Mode（固定模式）]

System Agent Load-Line Calibration（系統代理程式負載線路校正）

系統代理程式負載線路校正有助於防止系統代理程式電壓，在系統處於重度負載時驟降。

設定選項：[Auto（自動）] [Level 1（等級 1）] [Level 2（等級 2）] [Level 3（等級 3）] [Level 4（等級 4）] [Level 5（等級 5）]

Vcore Offset（Vcore 偏移）

讓您設定 Vcore 偏移的電壓。

VCCGT Voltage（VCCGT 電壓）

讓您設定 VCCGT 的電壓。

VDD_CPU Voltage（VDD_CPU 電壓）

讓您設定 VDD_CPU 的電壓。

MRC Voltage Configuration（MRC 電壓設定）

Vdd2Mv Voltage（Vdd2Mv 電壓）

與 DRAM 相連的 VR 軌道。通常等於或低於 VDD2 電壓。

Vddq Voltage（Vddq 電壓）

讓您設定 CPU FIVR TX Vddq。

Vcclog Voltage（Vcclog 電壓）

讓您設定 CPU FIVR VCC IOG。

VccClk Voltage (VccClk 電壓)

讓您設定 CPU FIVR VCC CLK。

DDR5 PMIC Configuration (DDR5 PMIC 設定)

PMIC Voltage Option (PMIC 電壓選項)

[統一] 讓您全面調整 DIMM PMIC。

[分離] 讓您個別調整 DIMM PMIC。

VDD Voltage (VDD 電壓)

讓您設定 DRAM 側 PMIC 支援的 VDD 電壓。可透過 PMIC ADC 測量 VDD 輸出，步距為 0.015V。VDD 資訊包含在記憶體 SPD 和 XMP 中，您可以透過記憶體資訊工具加以查看。

VDD Voltage Range (VDD 電壓範圍)

JEDEC 標準範圍從 0.800V 到 1.435V。OC 需求範圍從 0.800V 到 2.070V。如果 PMIC OC CAP 是 JEDEC PMIC，可能不會套用 OC 需求。您可以透過記憶體資訊工具加以查看。

設定選項：[JEDEC Standard (JEDEC 標準)] [OC Demand (OC 需求)]

VDDQ Voltage (VDDQ 電壓)

讓您設定 DRAM 側 PMIC 支援的 VDDQ 電壓。可透過 PMIC ADC 測量 VDDQ 輸出，步距為 0.015V。VDDQ 資訊包含在記憶體 SPD 和 XMP 中。您可以透過記憶體資訊工具加以查看。

設定選項：[JEDEC Standard (JEDEC 標準)] [OC Demand (OC 需求)]

VDDQ Voltage Range (VDDQ 電壓範圍)

JEDEC 標準範圍從 0.800V 到 1.435V。OC 需求範圍從 0.800V 到 2.070V。如果 PMIC OC CAP 是 JEDEC PMIC，可能不會套用 OC 需求。您可以透過記憶體資訊工具加以查看。

設定選項：[JEDEC Standard (JEDEC 標準)] [OC Demand (OC 需求)]

VPP Voltage (VPP 電壓)

讓您設定 DRAM 側 PMIC 支援的 VPP 電壓。可透過 PMIC ADC 測量 VPP 輸出，步距為 0.015V。VPP 資訊包含在記憶體 SPD 和 XMP 中。您可以透過記憶體資訊工具加以查看。

PMIC Protection Unlock (PMIC 保護解鎖)

讓您配置 PMIC 保護解鎖設定。

設定選項：[Auto (自動)] [Enabled (啟用)]

Current Limiter VDD (電流限制器 VDD)

讓您配置輸出電流限制器警告閾值設定。

設定選項：[Auto (自動)] [3.0 A] [3.5 A] [4.0 A] [Max TDC (最大 TDC)]

Current Limiter VDD (電流限制器 VDD)

讓您配置輸出電流限制器警告閾值設定。

設定選項：[Auto (自動)] [3.0 A] [3.5 A] [4.0 A] [Max TDC (最大 TDC)]

Current Limiter VPP (電流限制器 VPP)

讓您配置輸出電流限制器警告閾值設定。

設定選項：[Auto (自動)] [0.5 A] [1.0 A] [Reserved (保留)] [Max TDC (最大 TDC)]

PLL Voltage Configuration (PLL 電壓設定)

P-Core PLL Voltage Offset (P-Core PLL 電壓偏移)

PLL 電壓偏移值範圍從 0 到 15 個 bin，每個 bin 為 17.5mV。

E-Core PLL Voltage Offset (E-Core PLL 電壓偏移)

PLL 電壓偏移值範圍從 0 到 15 個 bin，每個 bin 為 17.5mV。

SOC System Agent PLL Voltage Offset (SOC 系統代理程式 PLL 電壓偏移)

PLL 電壓偏移值範圍從 0 到 15 個 bin，每個 bin 為 17.5mV。

CPU System Agent PLL Voltage Offset (CPU 系統代理程式 PLL 電壓偏移)

PLL 電壓偏移值範圍從 0 到 15 個 bin，每個 bin 為 17.5mV。

Memory Controller PLL Voltage Offset (記憶體控制器 PLL 電壓偏移)

PLL 電壓偏移值範圍從 0 到 15 個 bin，每個 bin 為 17.5mV。

P-Core PLL IRefTune Offset (P-Core PLL IRefTune 偏移)

PLL 電流參考調整偏移，範圍 0-15。將此欄位中提供的值，新增至 PLL 保險絲。新增偏移之後的值不得超過 0xF，如果超過，FW 會將值降至 0xF，再將值寫回至保險絲。

E-Core PLL Voltage Offset (E-Core PLL IRefTune 偏移)

PLL 電流參考調整偏移，範圍 0-15。將此欄位中提供的值，新增至 PLL 保險絲。新增偏移之後的值不得超過 0xF，如果超過，FW 會將值降至 0xF，再將值寫回至保險絲。

Ring PLL Voltage Offset (環形 PLL IRefTune 偏移)

PLL 電流參考調整偏移，範圍 0-15。將此欄位中提供的值，新增至 PLL 保險絲。新增偏移之後的值不得超過 0xF，如果超過，FW 會將值降至 0xF，再將值寫回至保險絲。

AVX Configuration (AVX 配置)**AVX2 Voltage Guardband Scale Factor (AVX2 電壓保護頻段比例因數)**

AVX2 電壓保護頻段比例因數，可控制套用至 AVX2 工作負載的電壓保護頻段。> 1.00 的值將擴大電壓保護頻段，< 1.00 的值將縮小電壓保護頻段。

Max Voltage Configuration (最大電壓設定)**P-Core Max Voltage Limits (P-Core 最大電壓限制)**

設定最大電壓限制。最大電壓應比 Vfused P0 大 200mV。

E-Core Max Voltage Limits (E-Core 最大電壓限制)

設定最大電壓限制。最大電壓應比 Vfused P0 大 200mV。

Ring Max Voltage Limits (環形最大電壓限制)

設定最大電壓限制。最大電壓應比 $V_{fused P0}$ 大 200mV。

GT Max Voltage Limits (GT 最大電壓限制)

設定最大電壓限制。最大電壓應比 $V_{fused P0}$ 大 200mV。

SA Max Voltage Limits (SA 最大電壓限制)

設定最大電壓限制。最大電壓應比 $V_{fused P0}$ 大 200mV。

EMemSS Max Voltage Limits (EMemSS 最大電壓限制)

設定最大電壓限制。最大電壓應比 $V_{fused P0}$ 大 200mV。

NGU Max Voltage Limits (NGU 最大電壓限制)

設定最大電壓限制。最大電壓應比 $V_{fused P0}$ 大 200mV。

VR Configuration (VR 設定)

IA AC Loadline (IA AC 負載線路)

可透過 AC 負載線路調整標稱 CPU VID 電壓。AC 負載線路越高，VID 就越高，尤其是高頻率或重負載。AC 負載線路以 mOhm 為單位。範圍是 0-20.00。0 = AUTO/HW 預設值。

IA DC Loadline (IA DC 負載線路)

可透過 DC 負載線路調整 CP 進行的功率計算。DC 負載線路以 mOhm 為單位。範圍是 0-20.00。0 = AUTO/HW 預設值。

CPU DLVR Configuration (CPU DLVR 設定)

CPU DLVR Mode (CPU DLVR 模式)

讓您選擇 CPU DLVR 模式。

設定選項：[Regulation Mode (調節模式)] [Bypassed Mode (旁路模式)]

Voltage Mode (電壓模式)

讓您選擇電壓模式。

設定選項：

[OC Mode (OC 模式)]：電壓範圍較大，適用於超頻。

[Stable Mode (穩定模式)]：電壓範圍較小，使系統穩定。

Core Input Voltage（核心輸入電壓）

讓您設定由外部電壓調節器輸入處理器的電壓。

設定選項：[Auto（自動）] [Offset Mode（偏移模式）] [Fixed Mode（固定模式）]

Core Input Voltage Load-Line Calibration（核心輸入電壓負載線路校正）

CPU Load-Line Calibration（CPU 防掉壓功能開關）可協助防止 CPU 電壓在系統處於重度負載時驟降。

設定選項：[Auto（自動）] [Level 1（等級 1）] [Level 2（等級 2）] [Level 3（等級 3）] [Level 4（等級 4）] [Level 5（等級 5）]

Save User Default（儲存使用者預設值）

鍵入設定檔名稱，然後按 **Enter** 將您的設定儲存為使用者預設值。

Load User Default（載入使用者預設值）

載入先前儲存的使用者預設值。

Save User UEFI Setup Profile to Disk（將使用者 UEFI 設定檔儲存至磁碟）

協助您將目前的 UEFI 設定儲存至磁碟，以作為使用者設定檔。

Load User UEFI Setup Profile from Disk（從磁碟載入使用者 UEFI 設定檔）

您可以從磁碟載入先前儲存的設定檔。

5.4 Advanced（進階）畫面

在此章節中，您可以設定下列項目：CPU 設定、晶片組設定、儲存裝置設定、Intel(R) Thunderbolt、ACPI 設定、USB 設定、可信賴運算、網路堆疊設定和 Intel(R) 快速儲存技術。



在此部分中，設定錯誤數值會造成系統故障。

UEFI Configuration（UEFI 設定）

UEFI Setup Style（UEFI 設定樣式）

讓您選擇進入 UEFI 設定公用程式時的預設模式。

設定選項：[Easy Mode（簡易模式）] [Advanced Mode（進階模式）]

Active Page on Entry（進入使用中頁面）

讓您選擇進入 UEFI 設定公用程式時的預設頁面。

設定選項：[My Favorite（常用項目）] [Main（主要）] [OC Tweaker] [Advanced（進階）] [Tool（工具）] [H/W Monitor（硬體監視器）] [Security（安全性）] [Boot（開機）] [Exit（退出）]

Full HD UEFI

[Auto (自動)]

選擇 [Auto (自動)] 時，如果顯示器支援 Full HD 解析度，則會將解析度設為 1920 x 1080。如果顯示器不支援 Full HD 解析度，則會將解析度設為 1024 x 768。

[Disabled (停用)]

選擇 [Disabled (停用)] 時，會直接將解析度設為 1024 x 768。

5.4.1 CPU Configuration (CPU 設定)



Processor P-Core Information (處理器 P-Core 資訊)

按 [Enter] 檢視 P-Core 資訊。

Processor E-Core Information (處理器 E-Core 資訊)

按 [Enter] 檢視 E-Core 資訊。

Active P-Cores (使用中 P-Core)

讓您選擇要在各處理器封裝中，啟用的核心數量。注意：同時查看 P-Core 和 E-Core 的數量。兩者都是 {0,0} 時，Pcode 將啟用所有核心。

Active P-Cores (現用處理器 E-Core)

讓您選擇要在各處理器封裝中，啟用的 E-Core 數量。注意：同時查看 P-Core 和 E-Core 的數量。兩者都是 {0,0} 時，Pcode 將啟用所有核心。

CPU C States Support (CPU C 狀態支援)

讓您啟用 CPU C 狀態支援以省電。建議維持啟用 C3、C6 及 C7，以獲得最佳的省電效率。

設定選項：[Enabled (啟用)] [Disabled (停用)]

C-State Auto Demotion (C 狀態自動降級)

讓您設定 C 狀態自動降級。

設定選項：[C1] [Disabled (停用)]

CState Un-demotion (CState 取消降級)

讓您設定 C 狀態取消降級。

設定選項：[C1] [Disabled (停用)]

Package C-State Demotion (封裝 C 狀態降級)

讓您啟用或停用封裝 C 狀態降級。

Package CState Un-demotion (封裝 CState 取消降級)

讓您啟用或停用封裝 C 狀態取消降級。

CState Pre-Wake (CState 預喚醒)

讓您啟用或停用 Cstate 預喚醒。停用 - 設為 1 以停用 Cstate 預喚醒。

IO MWAIT Redirection (IO MWAIT 重新導向)

讓您設定 IO MWAIT 重新導向。設定後，會將傳送的 IO_read 指令對映至 IO 暫存器 PMG_IO_BASE_ADDRBASE+offset to MWAIT(offset)。

設定選項：[Enabled (啟用)] [Disabled (停用)]

Package C State Support (封裝 C 狀態支援)

讓您啟用 CPU、PCIe、記憶體、顯示卡 C 狀態支援以省電。

DC6 Latency WA (DC6 延遲 WA)

讓您設定 DC6 延遲 WA。

CPU Thermal Throttling (CPU 溫度控制)

讓您啟用 CPU 內部溫度控制機制，以防止 CPU 過熱。

設定選項：[Enabled (啟用)] [Disabled (停用)]

Intel AVX/AVX2

讓您啟用或停用 Intel AVX 和 AVX2 指示。這僅適用於大核心。

設定選項：[Enabled (啟用)] [Disabled (停用)]

Intel Virtualization Technology (Intel 虛擬化技術)

Intel 虛擬化技術允許平台在獨立磁碟分割中執行多個作業系統及應用程式，使單一電腦系統可像多部虛擬系統一樣使用。

設定選項：[Enabled (啟用)] [Disabled (停用)]

X2APIC Enable (X2APIC 啟用)

讓您啟用或停用 X2APIC 運作模式。此選項設為「啟用」時，「VT-d」選項必須設

為「啟用」，「X2APIC Opt Out」選項也必須設為「停用」。
「VT-d」選項設為「停用」時，此選項將呈灰色。

Legacy Game Compatibility Mode（舊版遊戲相容性模式）

啟用時，按 Scroll Lock 鍵切換 Efficient 核心，停駐時 Scroll Lock LED 亮起，未停駐時 LED 熄滅。

設定選項：[Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

5.4.2 Chipset Configuration（晶片組設定）



Re-Size BAR Support（調整 BAR 大小支援）

如果系統有具備可調整大小 BAR 的 PCIe 裝置，則此選項可啟用或停用可調整大小 BAR 支援。

VT-d

Intel® Virtualization Technology for Directed I/O 可協助您的虛擬電腦顯示器改善應用程式相容性及可靠性，提升硬體的使用效率，並提供進一步的管理能力、安全性、隔離及 I/O 效能。

設定選項：[Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

SR-IOV Support（SR-IOV 支援）

如果系統有具 SR-IOV 功能的 PCIe 裝置，則此選項啟用或停用單根 IO 虛擬化支援。

設定選項：[Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

DMI Link Speed (DMI 連結速度)

讓您設定 DMI 插槽連結速度。

設定選項：[Gen1] [Gen2] [Gen3] [Gen4]

PCI Express Native Control (PCI Express 原生控制)

選擇啟用可加強 OS 中的 PCI Express 省電效果。

設定選項：[Enabled (啟用)] [Disabled (停用)]

PCIE ASPM Support (PCIE ASPM 支援)

此選項可控制所有 CPU 下游裝置的 ASPM 支援。

設定選項：[Disabled (停用)] [L0s] [L1] [L0sL1] [Auto (自動)]

PCH PCIE ASPM Support (PCH PCIE ASPM 支援)

此選項可控制所有 PCH 下游裝置的 ASPM 支援。

設定選項：[Disabled (停用)] [L0s] [L1] [L0sL1] [Auto (自動)]

PCH DMI ASPM Support (PCH DMI ASPM 支援)

讓您啟用或停用所有 PCH DMI 裝置的 ASPM 支援。

設定選項：[Disabled (停用)] [L0s] [L1] [L0sL1] [Auto (自動)]

DMI ASPM Support (DMI ASPM 支援)

讓您配置 PCH DMI ASPM 設定。

設定選項：[Disabled (停用)] [L0s] [L1] [L0sL1] [Auto (自動)]

PCIe Bifurcation (PCIe 分支)

讓您選擇 PCIe1 的寬度。

Onboard HD Audio (板載 HD 音訊)

讓您啟用或停用板載 HD 音訊控制器。將此項目設為 [Auto (自動)] 可啟用板載 HD，安裝音效卡後將自動停用。

設定選項：[Auto (自動)] [Enabled (啟用)] [Disabled (停用)]

Front Panel (前面板)

讓您選擇前面板類型。

[HD] 將前面板音訊接頭模式，設為高解析度音訊。

[AC'97] 將前面板音訊接頭模式設為舊版 AC'97。

Onboard HDMI HD Audio (板載 HDMI HD 音訊)

讓您啟用或停用板載數位輸出的音訊。

在主機板上安裝顯示卡後，會出現此項目。

設定選項：[Enabled (啟用)] [Disabled (停用)]。

Realtek 2.5G Ethernet Controller (Realtek 2.5G 乙太網路控制器)

讓您啟用或停用板載 LAN。

設定選項：[Enabled (啟用)] [Disabled (停用)]

Onboard WAN Device (板載 WAN 裝置)

讓您啟用或停用板載 WAN 裝置。

設定選項：[Enabled (啟用)] [Disabled (停用)]。

Deep Sleep (深沈睡眠)

讓您設定深沈睡眠模式，以在電腦關機時省電。建議停用深沈睡眠，以獲得更好的系統相容性和穩定性。

設定選項：[Enabled (啟用)] [Enabled in S5 (在 S5 下啟用)] [Enabled in S4-S5 (在

S4-S5 下啟用)]

Restore on AC/Power Loss (還原 AC/ 功率損耗)

讓您設定停電後的電源狀態。

[Power Off (電源關閉)] 可將電源設為在復電時保持關閉。

[Power On (電源開啟)] 可將系統設為在復電時開始開機。

NPU Device (NPU 裝置)

讓您啟用或停用 NPU (神經處理單元) 裝置。

5.4.3 Storage Configuration（儲存裝置設定）



SATA Controller(s) (SATA 控制器)

啟用 / 停用 SATA 控制器。

SATA Aggressive Link Power Management（SATA 積極性連結電源管理）

SATA 積極性連結電源管理允許 SATA 裝置在無動作期間進入低電源狀態以節省電力。僅 AHCI 模式支援此功能。

設定選項：[Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

5.4.4 Intel(R) Thunderbolt



PCIE Tunneling over USB4

讓您啟用或停用 PCIE Tunneling over USB4。

設定選項：[Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

Integrated Thunderbolt(TM) Enable（整合式 Thunderbolt(TM) 啟用）

讓您啟用或停用整合式 Thunderbolt(TM)。

設定選項：[Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

Discrete Thunderbolt(TM) Enable（獨立式 Thunderbolt(TM) 啟用）

讓您啟用或停用獨立式 Thunderbolt(TM)。

設定選項：[Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

此選項設為啟用時，會出現以下選項以供設定。

5.4.5 ACPI Configuration (ACPI 設定)



Suspend to RAM (載入到 RAM)

讓您針對 ACPI 載入類型 S1 選擇 [Disabled (停用)]。建議選擇自動，以節省 ACPI S3 的電力。

設定選項：[Auto (自動)] [Disabled (停用)]

PCIE Devices Power On (PCIE 裝置開機)

允許由 PCIE 裝置喚醒系統及啟用網路喚醒。

設定選項：[Enabled (啟用)] [Disabled (停用)]

RTC Alarm Power On (定時開機)

允許由真實時間鬧鈴喚醒系統。設為「By OS」即可由您的作業系統操控。

設定選項：[Enabled (啟用)] [Disabled (停用)] [By OS (透過 OS)]

USB Keyboard/Remote Power On (USB 鍵盤／遙控開機)

允許由 USB 鍵盤或遙控器喚醒系統。

設定選項：[Enabled (啟用)] [Disabled (停用)]

USB Mouse Power On (USB 滑鼠開機)

允許由 USB 滑鼠喚醒系統。

設定選項：[Enabled (啟用)] [Disabled (停用)]

5.4.6 USB Configuration (USB 設定)



XHCI Hand-off (XHCI 遞交)

這是不支援 XHCI 遞交的 OS 解決方法。應透過 XHCI 驅動程式宣告 XHCI 所有權變更。

設定選項：[Enabled (啟用)] [Disabled (停用)]

5.4.7 Trusted Computing（可信賴運算）



注意：選項因連接的 TPM 模組版本而異。

Security Device Support（安全性裝置支援）

讓您啟用或停用對安全性裝置的 BIOS 支援。作業系統不會顯示安全性裝置。TCG EFI 通訊協定及 INT1A 介面將無法使用。

設定選項：[Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

Active PCR banks（使用中 PCR 記憶庫）

此項目顯示使用中 PCR 記憶庫。

Available PCR Banks（可用的 PCR 記憶庫）

此項目顯示可用的 PCR 記憶庫。

SHA256 PCR Bank（SHA256 PCR 記憶庫）

讓您啟用或停用 SHA256 PCR 記憶庫。

設定選項：[Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

SHA384 PCR Bank（SHA384 PCR 記憶庫）

讓您啟用或停用 SHA384 PCR 記憶庫。

設定選項：[Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

SM3_256 PCR Bank（SM3_256 PCR 記憶庫）

讓您啟用或停用 SM3_256 PCR 記憶庫。

設定選項：[Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

Pending Operation（擱置操作）

讓您安排安全性裝置操作。

注意：您的電腦將在重新啟動時重開機以變更裝置狀態。

設定選項：[None（無）] [TPM Clear（TPM 清除）]

Platform Hierarchy（平台階層）

讓您啟用或停用平台階層。

設定選項：[Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

Storage Hierarchy（儲存階層）

讓您啟用或停用儲存階層。

設定選項：[Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

Endorsement Hierarchy（簽署階層）

讓您啟用或停用簽署階層。

設定選項：[Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

Physical Presence Spec Version（實體規格版本）

選擇此項目可告知作業系統支援 PPI 規格版本 1.2 或 1.3。請注意，部分 HCK 測試可能不支援版本 1.3。

設定選項：[1.2] [1.3]

TPM 2.0 InterfaceType

讓您檢視 TPM 2.0 裝置的通訊介面：CRB 或 ITS。

Device Select（裝置選擇）

讓您選擇要支援的 TPM 裝置。

[TPM 1.2] 將支援限制在 TPM 1.2 裝置。

[TPM 2.0] 將支援限制在 TPM 2.0 裝置。

[Auto（自動）] 支援 TPM 1.2 和 TPM 2.0 裝置，預設為 TPM 2.0 裝置。若找不到 TPM 2.0 裝置，將列舉出 TPM 1.2 裝置。

5.4.8 Network Stack Configuration（網路堆疊設定）



Network Stack（網路堆疊）

讓您啟用或停用 UEFI 網路堆疊。

設定選項：[Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

5.4.9 Intel(R) Rapid Storage Technology (Intel(R) 快速儲存技術)



此表單集讓使用者管理 Intel(R) RAID 控制器上的 RAID 磁區。有磁碟連接至系統時，頁面會顯示磁碟資訊。

Create RAID Volume (建立 RAID 磁區)

按 [Enter] 進入可讓您建立 RAID 磁區的頁面。

Name (姓名)

輸入不包含特殊字元且不超過 16 個字元的唯一磁區名稱。

RAID Level (RAID 層級)

使用此項目選擇 RAID 層級。選項因連接的磁碟而異。

設定選項：[RAID0 (等量)] [RAID1 (鏡像)] [RAID5 (同位)]

Select Disks (選擇磁碟)

使用此項目選擇要包含在 RAID 陣列中的硬碟。

Stripe Size (等量大小)

使用此項目為 RAID 陣列選擇等量大小。

Create Volume (建立磁區)

使用在上方指定的設定建立磁區。

5.5 Tools（工具）



Media Sanitization（媒體清理）

使用此工具安全地清除 SSD。此工具僅列出支援安全清除功能的 SSD。清理 SSD 後，所有使用者資料將在 SSD 上永久銷毀，且無法復原。

Auto Driver Installer

讓您自動下載並安裝所有必要的驅動程式。

[Enabled（啟用）]

選擇此項目以啟用 Auto Driver Installer 工具。啟用時，在可存取網際網路的情況下進入 Windows 後，Auto Driver Installer 工具將自動出現。

[Disabled（停用）]

選擇此項目以停用 Auto Driver Installer 工具。

UEFI Update Utility（UEFI 更新公用程式）

Instant Flash

讓您將 UEFI 檔案儲存在 USB 儲存裝置中，並執行 Instant Flash 以更新 UEFI。請注意，USB 儲存裝置必須是 FAT32/16/12 檔案系統。

5.6 Hardware Health Event Monitoring (硬體狀態監控) 畫面

本章節提供您監控系統硬體狀態的資訊，其中包括 CPU 溫度、主機板溫度、風扇速度及電壓參數。



注意：選項因主機板的功能而異。

風扇調整

測量風扇最小負載循環。

Fan-Tastic Tuning

選擇適用 CPU 風扇的風扇模式，或選擇 Customize (自訂) 設定 5 CPU 溫度，並為各溫度指定個別風扇速度。

CPU 風扇 1 設定

選擇適用 CPU 風扇 1 的風扇模式，或選擇 Customize (自訂) 設定 5 CPU 溫度，並為各溫度指定個別風扇速度。

CPU 風扇 2 設定

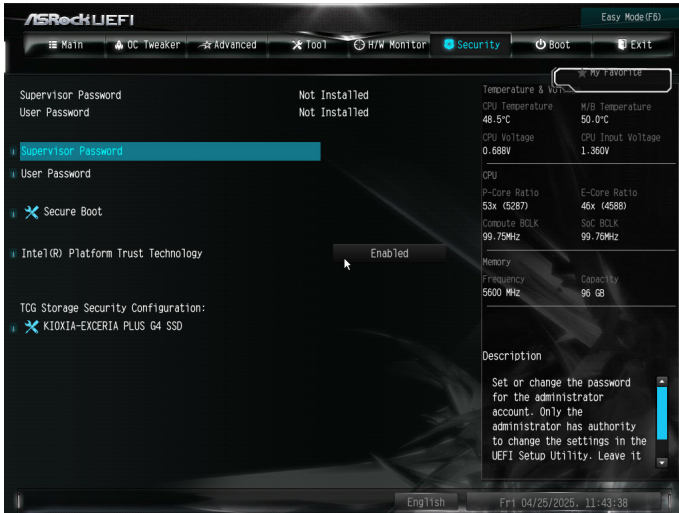
選擇適用 CPU 風扇 2 的風扇模式，或選擇 Customize (自訂) 設定 5 CPU 溫度，並為各溫度指定個別風扇速度。

CPU 風扇 2 溫度來源

選擇適用 CPU 風扇 2 的溫度來源。

5.7 Security（安全）畫面

在本章節中，您可設定或變更系統的監督員／使用者密碼。您也可清除使用者密碼。



管理員密碼

設定或變更管理員帳戶密碼。只有管理員有權變更 UEFI 設定公用程式中的設定。在此項目中留白並按下 **Enter** 即可移除密碼。

使用者密碼

設定或變更使用者帳戶密碼。使用者無法在 UEFI 設定公用程式中變更設定。在此項目中留白並按下 **Enter** 即可移除密碼。

安全開機

啟用以支援 安全開機。

TPM 裝置選擇

在 ME 中啟用 / 停用 PTT。停用此選項可使用分離式 TPM 模組。

5.8 Boot（開機）畫面

本章節顯示系統上供您設定開機設定與開機優先順序的可用裝置。



Fast Boot（快速開機）

快速開機可加快電腦的開機時間；但無法從 USB 儲存裝置開機。UEFI 感知作業系統或更新版本支援超快速模式，如果使用外部顯示卡，則需要支援 UEFI GOP 的 VBIOS。請注意，超快速模式的開機速度極快，因此進入此 UEFI 設定公用程式的唯一方式，是清除 CMOS 或在 Windows 中執行重新啟動進入 UEFI 公用程式。

設定選項：[Disabled（停用）] [Ultra Fast（超快速）]

Boot From Onboard LAN（從板載 LAN 開機）

允許由板載 LAN 喚醒系統。

設定選項：[Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

Setup Prompt Timeout（設定提示逾時）

讓您設定等待 UEFI 設定公用程式的秒數。

設定選項：[1] - [65535]

Bootup Num-Lock（開機後的數字鎖定鍵狀態）

讓您選擇系統開機時，應開啟或關閉 Num Lock。

設定選項：[On（開啟）] [Off（關閉）]

Boot Beep（開機嗶聲）

讓您選擇系統開機時，應開啟或關閉開機嗶聲。請注意，需配備蜂鳴器。

設定選項：[Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

Full Screen Logo（全螢幕標誌）

[Enabled（啟用）] 選擇此項目以顯示開機標誌。

[Disabled（停用）] 選擇此項目以顯示正常 POST 訊息。

Boot Failure Guard Message（開機失敗防護訊息）

若電腦多次無法開機，系統將自動還原回預設值。

設定選項：[Enabled（啟用）] [Disabled（停用）]

Boot Failure Guard Count（開機失敗防護計數）

讓您設定系統自動還原預設設定之前的嘗試開機次數

設定選項：[2] - [250]

5.9 Exit（結束）畫面



Save Changes and Exit（儲存變更並結束）

當您選擇此選項後，將彈出下列訊息「Save configuration changes and exit setup? (是否儲存設定變更並結束設定?)」。按下 <F10> 鍵或選擇 [Yes]（是）以儲存變更，並結束 UEFI 設定公用程式。

Discard Changes and Exit（捨棄變更並結束）

當您選擇此選項後，將彈出下列訊息「Discard changes and exit setup? (是否捨棄變更並結束設定?)」。按下 <ESC> 鍵或選擇 [Yes]（是）以結束 UEFI 設定公用程式，且不儲存任何變更。

Discard Changes（捨棄變更）

當您選擇此選項後，將彈出下列訊息「Discard changes? (是否捨棄變更?)」。按下 <F7> 鍵或選擇 [Yes]（是），以捨棄所有變更。

Load UEFI Defaults（載入 UEFI 預設值）

讓您為所有選項載入 UEFI 預設值。此操作可使用 F9 鍵。

Launch EFI Shell from filesystem device（在檔案系統裝置中啟動 EFI Shell）

讓您將 shellx64.efi 複製到根目錄，以啟動 EFI Shell。